

國立政治大學 函

機關地址：臺北市文山區指南路二段64號

機關傳真：29387749

承辦人：陳瑞英

聯絡電話：02-29393091#66899

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國107年2月26日

發文字號：政研發字第1070005021號

速別：最速件

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：科技部函、徵求公告、仿生材料附件

主旨：科技部推動107年度「智慧仿生材料與數位設計平台」專案研究計畫，自即日起受理申請，校內線上截止收件時間107年4月20日(星期五)下午5時，逾期不予受理，請查照轉知。

說明：

- 一、依科技部107年2月14日科部工字第1070012954號函辦理。
- 二、本計畫係為提升國內仿生工程的研發能量，朝向多功能性、高效率、低耗能、零污染的創新應用，來協助產業界開發新材料及發展新技術，並縮減產品商業化研發時程。鼓勵學者從智慧仿生的概念，藉由材料科學進入創新應用研究，技術發展成熟度由『創新材料結構設計研發』推向『系統結構或元件驗證』，以產生原創性的智慧仿生材料與元件系統技術，來提升國內產業在智慧仿生科技工程的需求及增進產業的競爭力。
- 三、本案將於107年3月5日假科技部2樓第13會議室舉辦專案說明會，擬參加說明會之人員請上網(報名網址<https://sites.google.com/site/msenctu2018/>)完成報名。
- 四、計畫申請注意事項：
 - (一)計畫研提以單一整合型四年期計畫為限，各主持人應實質參與研究，計畫書中應詳實註明各主持人負責之研究主題，整合之計畫需有整體明確的目標。每位主持人或共同主持人以參與本專案一件計畫為限，協同主持人不受此限。

- (二) 全程執行期程自107年8月1日起至111年7月31日止。每件計畫每年申請金額以不超過800萬元為原則。
- (三) 申請書採用科技部一般專題研究計畫之計畫書格式，其中表CM03研究計畫內容頁數以不超過40頁為限。本專案計畫書中須規劃研究項目及應用項目，且須針對各項核心技術評估其技術成熟度；並請將附件置於計畫書表CM03研究計畫內容最後。
- (四) 有意申請者，請於旨揭期限前至科技部專題研究計畫申請系統線上提出申請，計畫類別請勾選「一般型研究計畫」、研究型別請勾選「整合型計畫」、計畫歸屬請勾選「工程司」、學門代碼請勾選E9856（智慧仿生材料與數位設計平台專案計畫），以利作業。線上完成申請作業，請所屬單位於同年4月23日（星期一）中午12時前將申請名冊送達研發處，俾利函送科技部提出申請。

五、本計畫申請相關訊息請逕至科技部網站 (<http://www.most.gov.tw/>) -動態資訊(計畫徵求)或工程司網站 (<https://www.most.gov.tw/eng/ch>) -公告事項參閱。

六、計畫申請如有疑慮，請洽科技部劉春妙副研究員，電話：(02)2737-7526。有關係統操作問題，請洽本部資訊系統服務專線，電話：0800-212-058，(02)2737-7590、7591、7592。

正本：本校各院、所、系、中心

副本：研究發展處

校長 周 行 一